



日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

10/085, 204

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application: 2001年 2月 27日

出願番号

Application Number: 特願2001-053225

[ST.10/C]:

[JP2001-053225]

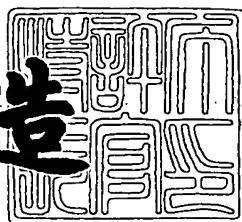
出願人

Applicant(s): 株式会社リコー

2002年 5月 14日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2002-3035042

【書類名】 特許願

【整理番号】 01001130

【提出日】 平成13年 2月27日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02B 6/42

【発明の名称】 光送受信システム

【請求項の数】 3

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 関谷 卓朗

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 桜井 彰

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 加藤 正良

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 古田 輝幸

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 宮垣 一也

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 金井 健

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 和多田 篤行

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 佐藤 俊一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 鈴木 幸栄

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 菅原 悟

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 佐藤 新治

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 鬼地 秀一

【特許出願人】

【識別番号】 000006747

【氏名又は名称】 株式会社リコー

【代表者】 桜井 正光

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003724

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光送受信システム

【特許請求の範囲】

【請求項1】 発振波長が1.1μm～1.7μmであり、光を発生する活性層を、主たる元素がGa、In、N、Asからなる層、もしくはGa、In、Asよりなる層とし、レーザ光を得るために前記活性層の上部及び下部に設けられた反射鏡を含んだ共振器構造を有する面発光型半導体レーザ素子チップであって、前記反射鏡はそれを構成する材料層の屈折率が小／大と周期的に変化し入射光を光波干渉によって反射する半導体分布プラグ反射鏡であるとともに、前記屈折率が小の材料層は $Al_xGa_{1-x}As$ ($0 < x \leq 1$) とし、前記屈折率が大の材料層は $Al_yGa_{1-y}As$ ($0 \leq y < x \leq 1$) とした反射鏡であり、かつ前記屈折率が小と大の材料層の間に該屈折率が小と大の間の値をとる材料層 $Al_zGa_{1-z}As$ ($0 \leq y < z < x \leq 1$) を設けてなる面発光型半導体レーザ素子チップを発光光源とし、該発光光源に光信号を伝送するための光ファイバー伝送路を光学的にカップリングさせるとともに、前記伝送路の前記発光光源と反対側に光学的にカップリングさせた受光ユニットを設けた光送受信システムにおいて、該光送受信システムは、前記発光光源を設置した場所Aと前記受光ユニットを設置した場所Bを含むとともに、前記場所Aと場所Bの間の前記伝送路の方向変換は、前記光ファイバーそのものを角度を付けずに曲げて行うことを特徴とする光送受信システム。

【請求項2】 発振波長が1.1μm～1.7μmであり、光を発生する活性層を、主たる元素がGa、In、N、Asからなる層、もしくはGa、In、Asよりなる層とし、レーザ光を得るために前記活性層の上部及び下部に設けられた反射鏡を含んだ共振器構造を有する面発光型半導体レーザ素子チップであって、前記反射鏡はそれを構成する材料の屈折率が小／大と周期的に変化し入射光を光波干渉によって反射する半導体分布プラグ反射鏡であるとともに、前記屈折率が小の材料は $Al_xGa_{1-x}As$ ($0 < x \leq 1$) とし、前記屈折率が大の材料は $Al_yGa_{1-y}As$ ($0 \leq y < x \leq 1$) とした反射鏡であり、前記活性層と前記反射鏡の間にGaInPもしくはGaInPAsよりなる非発光再結合防止層を

設けてなる面発光型半導体レーザ素子チップを発光光源とし、該発光光源に光信号を伝送するための光ファイバー伝送路を光学的にカップリングさせるとともに、前記伝送路の前記発光光源と反対側に光学的にカップリングさせた受光ユニットを設けた光送受信システムにおいて、該光送受信システムは、前記発光光源を設置した場所Aと前記受光ユニットを設置した場所Bを含むとともに、前記場所Aと場所Bの間の前記伝送路の方向変換は、前記光ファイバーそのものを角度を付けずに曲げて行うことを特徴とする光送受信システム。

【請求項3】 前記伝送路の方向変換は、前記光ファイバーを連続的に曲げて行うことを特徴とする請求項1、2に記載の光送受信システム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は光通信などに用いられる半導体レーザならびにその光通信システムに関するものであり、中でも半導体レーザとして製作に使用する半導体基板面に対して垂直方向に光を発するいわゆる面発光レーザを用いた光通信システムに関するものである。

【0002】

【従来の技術】

面発光半導体レーザは、基板の表面から垂直方向にレーザ光を放射するので2次元並列集積が可能であり、更に、その出力光の広がり角が比較的狭い（10度前後）ので光ファイバとの結合が容易であるほか、素子の検査が容易であるという特徴を有している。そのため、特に、並列伝送型の光送信モジュール（光インタコネクション装置）を構成するのに適した素子として開発が盛んに行なわれている。光インタコネクション装置の当面の応用対象は、コンピュータ等の筐体間やボード間の並列接続のほか、短距離の光ファイバー通信であるが、将来の期待される応用として大規模なコンピュータ・ネットワークや長距離大容量通信の幹線系がある。

【0003】

一般に、面発光半導体レーザは、GaAs又はGaInAsからなる活性層と、

当該活性層を上下に挟んで配置された上部の半導体分布プラック反射鏡と基板側の下部の半導体分布プラック反射鏡からなる光共振器をもって構成するのが普通であるが、端面発光型半導体レーザの場合に比較して光共振器の長さが著しく短いため、反射鏡の反射率を極めて高い値(99%以上)に設定することによってレーザ発振を起こし易くする必要がある。このため、通常は、AlAs からなる低屈折率材料とGaAs からなる高屈折率材料を1/4波長の周期で交互に積層することによって形成した半導体分布プラック反射鏡が使用されている。

【0004】

ところで上記のように、光通信に使用されるようなレーザ波長が1.1μm以上の長波長帯レーザ、例えばレーザ波長が1.3μm帯や1.55μm帯であるような長波長帯レーザは、製作基板にInPが用いられ、活性層にInGaAsPが用いられるが、基板のInPの格子定数が大きく、これに整合する反射鏡材料では屈折率差が大きく取れず、従って積層数を40対以上とする必要がある。またInP基板上に形成される半導体レーザには、別の問題として、温度によって特性が大きく変化する点がある。そのため、温度を一定にする装置を附加して使用する必要があり、民生用等一般用に供することが困難であり、このような積層数と温度特性の問題から、実用的な長波長帯面発光半導体は、未だ実用化されるに至っていない。

【0005】

このような問題を解決するためになされた発明として、特開平9-237942号公報に開示されたものが知られている。それによると、製作基板としてGaAs 基板を用い、基板側の下部上部のうち少なくとも一方の半導体分布プラック反射鏡の低屈折率層に同基板と格子整合が取れるAlInP からなる半導体層を用い、さらに、下部上部のうち少なくとも一方の半導体分布プラック反射鏡の高屈折率層にGaNAs からなる半導体層を用い、従来よりも大きい屈折率差を得るようにし、少ない積層数で高反射率の半導体分布プラック反射鏡を実現しようというものである。

【0006】

また、GaNAs を活性層の材料として使用している。これは、N組成を増

加させることによってバンドギャップ（禁制帯幅）を1.4eVから0eVへ向かって低下させることができるので、0.85μmよりも長い波長を発光する材料として用いることが可能となるからである。しかもGaAs基板と格子整合が可能なので、GaInNAsからなる半導体層は、1.3μm帯及び1.55μm帯の長波長帯面発光半導体レーザのための材料として好ましい点についても言及している。

【0007】

しかしながら、従来は0.85μmよりも長い波長帯の面発光半導体レーザ実現の可能性を示唆するにとどまっているだけであり、実際にはそのようなものは実現していない。これは基本的な構成は理論的にはほぼ決まっているものの実際に安定したレーザ発光が得られるようにするためにより具体的な構成がまだ不明だからである。

【0008】

一例を挙げると、上記のようにAlAsからなる低屈折率材料とGaAsからなる高屈折率材料を1/4波長の周期で交互に積層することによって形成した半導体分布ブレグ反射鏡を使用したものや、あるいは特開平9-237942号公報に開示されたもののように、半導体分布ブレグ反射鏡の低屈折率層に同基板と格子整合が取れるAlInPからなる半導体層を用いたものにおいては、レーザ素子が全く発光しなかったり、あるいは、発光してもその発光効率が低く、実用レベルには程遠いものであった。これは、Alを含んだ材料が化学的に非常に活性であり、Alに起因する結晶欠陥が生じ易いためである。これを解決するためには、特開平8-340146号公報や特開平7-307525号公報に開示された発明のようにAlを含まないGaInNとGaAsとから半導体分布ブレグ反射鏡を構成する提案がある。しかしながらGaInNとGaAsとの屈折率差はAlAsとGaAsとの屈折率差に比べて約半分であり、反射鏡の積層数を非常に多くなり製作が困難となる。

【0009】

すなわち現状では、コンピュータ・ネットワークなどで光ファイバー通信が期待されているが、それに使用できるレーザ波長が1.1μm～1.7μmの長波

長帯面発光半導体レーザおよびそれを用いた通信システムが存在せず、その出現が切望されている。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】

本発明はこのような光通信などに用いられるレーザ発振波長が1. 1 μ m～1. 7 μ mの長波長帯面発光半導体レーザならびにその光送受信システムに関するものであり、その第1の目的は、動作電圧、発振閾値電流等を低くできる面発光型半導体レーザ素子チップを発光光源として利用し、2つの場所をつなぐこのような光送受信システム構築が容易にできるようにすることにある。

【0011】

また第2の目的も、安定して使用できるレーザ発振波長が1. 1 μ m～1. 7 μ mの長波長帯面発光半導体レーザ素子チップを発光光源として利用し、2つの場所をつなぐこのような光送受信システム構築が容易にできるようにすることにある。

【0012】

さらに第3の目的は、このような光送受信システム構築が容易にできるような具体的な方法を提案することにある。

【0013】

【課題を解決するための手段】

本発明は前記目的を達成するために第1に、発振波長が1. 1 μ m～1. 7 μ mであり、光を発生する活性層を、主たる元素がGa、In、N、Asからなる層、もしくはGa、In、Asよりなる層とし、レーザ光を得るために前記活性層の上部及び下部に設けられた反射鏡を含んだ共振器構造を有する面発光型半導体レーザ素子チップであって、前記反射鏡はそれを構成する材料層の屈折率が小／大と周期的に変化し入射光を光波干渉によって反射する半導体分布プラック反射鏡であるとともに、前記屈折率が小の材料層はAl_xGa_{1-x}As (0 < x ≤ 1) とし、前記屈折率が大の材料層はAl_yGa_{1-y}As (0 ≤ y < x ≤ 1) とした反射鏡であり、かつ前記屈折率が小と大の材料層の間に該屈折率が小と大の間の値をとる材料層Al_zGa_{1-z}As (0 ≤ y < z < x ≤ 1) を設けてなる面発光型

半導体レーザ素子チップを発光光源とし、該発光光源に光信号を伝送するための光ファイバー伝送路を光学的にカップリングさせるとともに、前記伝送路の前記発光光源と反対側に光学的にカップリングさせた受光ユニットを設けた光送受信システムにおいて、該光送受信システムは、前記発光光源を設置した場所Aと前記受光ユニットを設置した場所Bを含むとともに、前記場所Aと場所Bの間の前記伝送路の方向変換は、前記光ファイバーそのものを角度を付けずに曲げて行うようにした。

【0014】

また第2に、発振波長が $1.1\text{ }\mu\text{m}$ ～ $1.7\text{ }\mu\text{m}$ であり、光を発生する活性層を、主たる元素がGa、In、N、Asからなる層、もしくはGa、In、Asよりなる層とし、レーザ光を得るために前記活性層の上部及び下部に設けられた反射鏡を含んだ共振器構造を有する面発光型半導体レーザ素子チップであって、前記反射鏡はそれを構成する材料の屈折率が小／大と周期的に変化し入射光を光波干渉によって反射する半導体分布プラグ反射鏡であるとともに、前記屈折率が小の材料は $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ ($0 < x \leq 1$) とし、前記屈折率が大の材料は $\text{Al}_y\text{Ga}_{1-y}\text{As}$ ($0 \leq y < x \leq 1$) とした反射鏡であり、前記活性層と前記反射鏡の間にGaInPもしくはGaInPAsよりなる非発光再結合防止層を設けてなる面発光型半導体レーザ素子チップを発光光源とし、該発光光源に光信号を伝送するための光ファイバー伝送路を光学的にカップリングさせるとともに、前記伝送路の前記発光光源と反対側に光学的にカップリングさせた受光ユニットを設けた光送受信システムにおいて、該光送受信システムは、前記発光光源を設置した場所Aと前記受光ユニットを設置した場所Bを含むとともに、前記場所Aと場所Bの間の前記伝送路の方向変換は、前記光ファイバーそのものを角度を付けずに曲げて行うようにした。

【0015】

さらに第3に、上記第1、第2の光通信システムにおいて、前記伝送路の方向変換は、前記光ファイバーを連続的に曲げて行うようにした。

【0016】

【発明の実施の形態】

最初に本発明の光通信システムに適用される発光素子である伝送ロスの少ないレーザ発振波長が $1.1 \mu m$ ～ $1.7 \mu m$ の長波長帯面発光半導体レーザの1例について図1を用いて説明する。

【0017】

前述のように、従来は本発明が適用しようとしているレーザ発振波長が $1.1 \mu m$ ～ $1.7 \mu m$ の長波長帯面発光半導体レーザに関しては、その可能性の示唆があるのみで、実現のための材料、ならびにより具体的、詳細な構成は不明であった。本発明では、活性層として $GaInNAs$ 等の材料を使用し、さらに具体的な構成を明確にした。以下にそれを詳述する。

【0018】

本発明では、面方位 (100) の $n-GaAs$ 基板上に、それぞれの媒質内における発振波長 λ の $1/4$ 倍の厚さ ($\lambda/4$ の厚さ) で $n-Al_xGa_{1-x}As$ ($x = 1.0$) (低屈折率層～屈折率小の層) と $n-Al_yGa_{1-y}As$ ($y = 0$) (高屈折率層～屈折率大の層) を交互に 35 周期積層した n -半導体分布プラッタ反射鏡 ($AlAs/GaAs$ 下部半導体分布プラッタ反射鏡) を形成し、その上に $\lambda/4$ の厚さの $n-Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($x = 0.5, y = 1$) 層を積層した。この例では $n-Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($x = 0.5, y = 1$) 層も下部反射鏡の一部であり低屈折率層 (屈折率小の層) となっている。

【0019】

そしてその上にアンドープ下部 $GaAs$ スペーサ層と、3層の $Ga_xIn_{1-x}As$ 量子井戸層である活性層 (量子井戸活性層) と $GaAs$ バリア層 (20 nm) からなる多重量子井戸活性層と、アンドープ上部 $GaAs$ スペーサ層とが積層されて、媒質内における発振波長 λ の 1 波長分の厚さ (λ の厚さ) の共振器を形成している。

【0020】

さらにその上に、C (炭素) ドープの $p-Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($x = 0.5, y = 1$) 層と Zn ドープ $p-Al_xGa_{1-x}As$ ($x = 0$) をそれぞれの媒質内における発振波長 λ の $1/4$ 倍の厚さで交互に積層した周期構造 (1 周期) を積層し、その上に C ドープの $p-Al_xGa_{1-x}As$ ($x = 0.9$) と Zn ドープ

$p-Al_xGa_{1-x}As$ ($x = 0$) をそれぞれの媒質内における発振波長 λ の $1/4$ 倍の厚さで交互に積層した周期構造 (25周期) とからなる半導体分布プラッタ反射鏡 ($Al_{0.9}Ga_{0.1}As/GaAs$ 上部半導体分布プラッタ反射鏡) を形成している。この例では $p-Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($x = 0.5, y = 1$) 層も上部反射鏡の一部であり、低屈折率層 (屈折率小の層) となっている。

【0021】

なおここで、上部／下部反射鏡ともそれぞれ低屈折率層 (屈折率小の層)／高屈折率層 (屈折率大の層) を交互に積層して形成するが、本発明ではこれらの間に、屈折率が小と大の間の値をとる材料層 $Al_zGa_{1-z}As$ ($0 \leq y < z < x \leq 1$) を設けている。図2は、低屈折率層 (屈折率小の層) と高屈折率層 (屈折率大の層) の間に、屈折率が小と大の間の値をとる材料層 $Al_zGa_{1-z}As$ ($0 \leq y < z < x \leq 1$) を設けた半導体分布プラッタ反射鏡の一部を示したものである (図1では図が複雑になるので図示することを省略している)。

【0022】

従来レーザ波長が $0.85\mu m$ 帯の半導体レーザに関して、このような材料層を設けることも検討はされているが、まだ検討段階であり、その材料、あるいはその厚さなどまで詳細には検討されていない。また本発明のようなレーザ発振波長が $1.1\mu m \sim 1.7\mu m$ の長波長帯面発光半導体レーザに関しては全く検討されていない。その理由はこの分野 (レーザ発振波長が $1.1\mu m \sim 1.7\mu m$ の長波長帯面発光半導体レーザ) が新しい分野であり、まだほとんど研究が進んでいないからである。

【0023】

本発明者はいち早くこの分野 (レーザ発振波長が $1.1\mu m \sim 1.7\mu m$ の長波長帯面発光半導体レーザおよびそれを用いた光通信) の有用性に気付き、それを実現するために銳意検討を行った。

【0024】

このような材料層は形成時にガス流量をコントロールするなどして、その Al 組成を連続的もしくは段階的に変えるようにしてその材料層の屈折率が連続的もしくは段階的に変化するようにして形成する。

【0025】

より具体的には、 $Al_zGa_{1-z}As$ ($0 \leq y < z < x \leq 1$) 層の z の値を 0 から 1.0 まで変わるように、つまり $GaAs \sim AlGaAs \sim AlAs$ という具合に Al と Ga の比率が徐々に変わるようにして形成する。これは前述のように層形成時にガス流量をコントロールすることによって作成される。また、 Al と Ga の比率が前述のように連続的に変わるようにして形成しても良いし、段階的にその比率が変わるようにしても同等の効果がある。

【0026】

このような材料層を設ける理由は、半導体分布プラグ反射鏡の持つ問題点の一つである p -半導体分布プラグ反射鏡の電気抵抗が高いという課題を解決するためである。これは半導体分布プラグ反射鏡を構成する 2 種類の半導体層の界面に生じるヘテロ障壁が原因であるが、本発明のように低屈折率層と高屈折率層の界面に一方の組成から他方の組成へ次第に Al 組成が変化するようにして、屈折率も変化させることによってヘテロ障壁の発生を抑制することが可能である。

【0027】

またこのような屈折率が小と大の間の値をとる材料層 $Al_zGa_{1-z}As$ ($0 \leq y < z < x \leq 1$) は本発明のようなレーザ発振波長が $1.1 \mu m \sim 1.7 \mu m$ の長波長帯面発光半導体レーザの場合、 $5 nm \sim 50 nm$ の厚さとするのが良く、これより薄いと抵抗が大となり電流が流れにくく、素子が発熱したり、駆動エネルギーが高くなるという不具合がある。また厚いと抵抗が小となり、素子の発熱や、駆動エネルギーの面で有利になるが、今度は反射率がとれないという不具合があり、前述のように最適の範囲 ($5 nm \sim 50 nm$ の厚さ) を選ぶ必要がある。

【0028】

なお、前述のように従来のレーザ波長が $0.85 \mu m$ 帯の半導体レーザについてこのような材料層を設けることも検討されているが、本発明のようなレーザ発振波長が $1.1 \mu m \sim 1.7 \mu m$ の長波長帯面発光半導体レーザの場合は、より効果的である。なぜなら、例えば同等の反射率 (例えば 99.5% 以上) を得る

ためには、0.85 μm帯よりも1.1 μm帯～1.7 μm帯の場合、このような材料層を約2倍程度にすることができるので、半導体分布プラグ反射鏡の抵抗値を低減させることができ、動作電圧、発振閾値電流等が低くなり、レーザ素子の発熱防止ならびに安定発振、少エネルギー駆動の面で有利となる。

【0029】

つまり半導体分布プラグ反射鏡にこのような材料層を設けることは、本発明のようなレーザ発振波長が1.1 μm～1.7 μmの長波長帯面発光半導体レーザの場合に特に効果的な工夫といえる。

【0030】

なお効果的な反射率を得るためのより詳細な検討結果の一例を挙げると、例えば1.3 μm帯面発光型レーザ素子では、 $Al_xGa_{1-x}As$ ($x = 1.0$) (低屈折率層～屈折率小の層) と $Al_yGa_{1-y}As$ ($y = 0$) (高屈折率層～屈折率大の層) を20周期積層した場合においては、半導体分布プラグ反射鏡の反射率が99.7%以下となる $Al_zGa_{1-z}As$ ($0 \leq y < z < x \leq 1$) 層の厚さは30 nmである。また、反射率が99.5%以上となる波長帯域は53 nmであり、反射率を99.5%以上と設計した場合、±2%の膜厚制御ができればよい。そこでこれと同等およびこれより薄い、10 nm、20 nm、30 nmのものを試作したところ、反射率を実用上問題のない程度に保つことができ、半導体分布プラグ反射鏡の抵抗値を低減させることができた1.3 μm帯面発光型レーザ素子を実現、レーザ発振に成功した。なお試作したレーザ素子の他の構成は後述のとおりである。

【0031】

なお多層膜反射鏡においては設計波長（膜厚制御が完全にできたとして）を含んで反射率の高い帯域がある。高反射率の帯域（反射率が狙いの波長に対して必要値以上である領域を含む）と呼ぶ。設計波長の反射率が最も高く、波長が離れるにしたがってごくわずかずつ低下している領域である。これはある領域から急激に低下する。そして狙いの波長に対して必要な反射率以上となるように、本来、多層膜反射鏡の膜厚を原子層レベルで完全に制御する必要がある。しかし実際には±1%程度の膜厚誤差は生じるので狙いの波長と最も反射率の高い波長はず

れてしまう。例えば狙いの波長が $1.3 \mu\text{m}$ の場合、膜厚制御が 1 % ずれたとき、最も反射率の高い波長は 1.3 nm ずれてしまう。よってこの高反射率の帯域（ここでは反射率が狙いの波長に対して必要値以上である領域）は広い方が望ましい。しかし中間層を厚くするとこの帯域が狭くなる傾向にある。

【0032】

このように本発明のようなレーザ発振波長が $1.1 \mu\text{m} \sim 1.7 \mu\text{m}$ の長波長帯面発光半導体レーザにおいて、このような半導体分布プラグ反射鏡の構成を工夫、最適化することにより、反射率を高く維持したまま抵抗値を低減させることができるので、動作電圧、発振閾値電流等を低くでき、レーザ素子の発熱防止ならびに安定発振、少エネルギー駆動が可能となる。

【0033】

再び図1に戻り、最上部の、 $p - Al_xGa_{1-x}As$ ($x = 0$) 層は、電極とコンタクトを取るためのコンタクト層 (p -コンタクト層) としての役割も持っている。

【0034】

ここで、量子井戸活性層の In 組成 x は 39 % ($Ga0.61In0.39As$) とした。また量子井戸活性層の厚さは 7 nm とした。なお量子井戸活性層は、 $GaAs$ 基板に対して約 2.8 % の圧縮歪を有していた。

【0035】

またこの面発光型半導体レーザ全体の成長方法は MOCVD 法で行った。この場合、格子緩和は見られなかった。半導体レーザの各層を構成する原料には、 TMA (トリメチルアルミニウム)、 TMG (トリメチルガリウム)、 TMI (トリメチルインジウム)、 AsH_3 (アルシン)、 PH_3 (fosfin) を用いた。また、キャリアガスには H_2 を用いた。図1に示した素子の活性層 (量子井戸活性層) のように歪が大きい場合は、非平衡となる低温成長が好ましい。ここでは、 $GaInAs$ 層 (量子井戸活性層) は 550°C で成長させている。ここで使用した MOCVD 法は過飽和度が高く高歪活性層の結晶成長に適している。また MBE 法のような高真空を必要とせず、原料ガスの供給流量や供給時間を制御すれば良いので量産性にも優れている。

【0036】

またこの例では、電流経路外の部分をプロトン (H^+) 照射によって絶縁層（高抵抗部）を作り、電流狭さく部を形成した。

【0037】

そしてこの例では、上部反射鏡の最上部の層であり上部反射鏡一部となっているp-コンタクト層上に光出射部を除いてp側電極を形成し、基板の裏面にn側電極を形成した。

【0038】

この例では、上下反射鏡に挟まれた、キャリアが注入され再結合する活性領域（本実施例では上部及び下部スペーサ層と多重量子井戸活性層とからなる共振器）において、活性領域内にはA1を含んだ材料（III族に占める割合が1%以上）を用い、さらに、下部及び上部反射鏡の低屈折率層の最も活性層に近い層を $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1, 0 < y \leq 1$) の非発光再結合防止層としている。キャリアは、活性層に最も近くワイドギャップである上部及び下部反射鏡の低屈折率層間に閉じ込められるので、活性領域のみをA1を含まない層（II族に占める割合が1%以下）で構成しても活性領域に接する反射鏡の低屈折率層（ワイドギャップ層）にA1を含んだ構造としたのでは、キャリアが注入され再結合する時、この界面で非発光再結合が生じ発光効率は低下してしまう。よって活性領域はA1を含まない層で構成することが望ましい。

【0039】

またこの $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1, 0 < y \leq 1$) 層よりなる非発光再結合防止層は、その格子定数がGaAs基板よりも小さく、引張り歪を有している。

【0040】

エピタキシャル成長では下地の情報を反映して成長するので基板表面に欠陥があると成長層へ這い上がっていく。しかし歪層があるとそのような欠陥の這い上がりが抑えられ効果があることが知られている。

【0041】

上記欠陥が活性層に達すると発光効率を低減させてしまう。また、歪を有する

活性層では臨界膜厚が低減し必要な厚さの層を成長できないなどの問題が生じる。特に活性層の圧縮歪量が例えば2%以上と大きい場合や、歪層の厚さ臨界膜厚より厚く成長する場合、低温成長などの非平衡成長を行っても欠陥の存在で成長できないなど、特に問題となる。歪層があるとそのような欠陥の這い上がりが抑えられるので、発光効率を改善したり、活性層の圧縮歪量が例えば2%以上の層を成長できたり、歪層の厚さを臨界膜厚より厚く成長することが可能となる。

【0042】

この $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1, 0 < y \leq 1$) 層は活性領域に接しており活性領域にキャリアを閉じ込める役割も持っているが、 $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1, 0 < y \leq 1$) 層は格子定数が小さくなるほどバンドギャップエネルギーを大きく取り得る。例えば $Ga_xIn_{1-x}P$ ($y = 1$ の場合) の場合、 x が大きくなり GaP に近づくと格子定数が大きくなり、バンドギャップは大きくなる。バンドギャップ Eg は、直接遷移で $Eg(\Gamma) = 1.351 + 0.643x + 0.786x^2$ 、間接遷移で $Eg(X) = 2.24 + 0.02x$ と与えられている。よって活性領域と $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1, 0 < y \leq 1$) 層のヘテロ障壁は大きくなるのでキャリア閉じ込めが良好となり、しきい値電流低減、温度特性改善などの効果がある。

【0043】

さらにこの $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1, 0 < y \leq 1$) 層よりなる非発光再結合防止層は、その格子定数が $GaAs$ 基板よりも大きく、圧縮歪を有しており、かつ前記活性層の格子定数が前記 $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1, 0 < y \leq 1$) 層よりも大きく圧縮歪を有している。

【0044】

またこの $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1, 0 < y \leq 1$) 層の歪の方向が活性層と同じ方向なので、活性層が感じる実質的な圧縮歪量を低減する方向に働く。歪が大きいほど外的要因の影響を受けやすいので、活性層の圧縮歪量が例えば2%以上と大きい場合や、臨界膜厚を超えた場合に特に有効である。

【0045】

例えば発振波長が1.3 μm 帯の面発光型レーザは $GaAs$ 基板上に形成する

のが好ましく、共振器には半導体多層膜反射鏡を用いる場合が多く、トータル厚さが5~8 μmで50~80層の半導体層を活性層成長前に成長する必要がある。（一方、端面発光型レーザの場合、活性層成長前のトータル厚さは2 μm程度で3層程度の半導体層を成長するだけで良い。）この場合、高品質のGaAs基板を用いてもさまざまな原因（一度発生した欠陥は基本的には結晶成長方向に這い上がるし、ヘテロ界面での欠陥発生などがある）でGaAs基板表面の欠陥密度に比べて活性層成長直前の表面の欠陥密度はどうしても増えてしまう。活性層成長以前に、歪層の挿入や、活性層が感じる実質的な圧縮歪量が低減すると、活性層成長直前の表面にある欠陥の影響を低減できるようになる。

【0046】

この例では、活性領域内及び反射鏡と活性領域との界面にAlを含まない構成としたので、キャリア注入時にAlに起因していた結晶欠陥が原因となる非発光再結合がなくなり、非発光再結合が低減した。

【0047】

前述のように、反射鏡と活性領域との界面にAlを含まない構成とする、すなわち非発光再結合防止層を設けることを、上下反射鏡とともに適用することが好ましいが、一方の反射鏡に適用するだけでも効果がある。またこの例では、上下反射鏡とも半導体分布プラグ反射鏡としたが、一方の反射鏡を半導体分布プラグ反射鏡とし、他方の反射鏡を誘電体反射鏡としても良い。また前述の例では、反射鏡低屈折率層の最も活性層に近い層のみを $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1$ 、 $0 < y \leq 1$) の非発光再結合防止層としているが、複数層の $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1$ 、 $0 < y \leq 1$) を非発光再結合防止層としても良い。

【0048】

さらにこの例では、GaAs基板と活性層との間の下部反射鏡にこの考えを適用し、活性層の成長時に問題となる、Alに起因する結晶欠陥の活性層への這い上がりによる悪影響が押さえられ、活性層を高品質に結晶成長することができる。これらにより、発光効率は高く、信頼性は実用上十分な面発光型半導体レーザが得られた。また、半導体分布プラグ反射鏡の低屈折率層のすべてではなく、少なくとも活性領域に最も近い部分をAlを含まない $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ (

$0 < x < 1, 0 < y \leq 1$) 層としただけなので、反射鏡の積層数を特に増加させることなく、上記効果を得ることができている。

【0049】

このようにして製作した面発光型半導体レーザの発振波長は約 $1.2 \mu\text{m}$ であった。GaAs基板上のGaInAsは、In組成の増加で長波長化するが歪み量の増加をともない、従来 $1.1 \mu\text{m}$ までが長波長化の限界と考えられていた（文献「IEEE Photonics. Technol. Lett. Vol. 9 (1997) pp. 1319-1321」参照）。

【0050】

しかしながら今回発明者が製作したように、 600°C 以下の低温成長などの非平衡度の高い成長法により高歪のGaInAs量子井戸活性層を従来より厚くコヒーレント成長することが可能となり、波長は $1.2 \mu\text{m}$ まで到達できた。なおこの波長はSi半導体基板に対して透明である。従ってSi基板上に電子素子と光素子を集積した回路チップにおいてSi基板を通した光伝送が可能となる。

【0051】

以上の説明より明らかのようにIn組成が大きい高圧縮歪のGaInAsを活性層に用いることにより、GaAs基板上に長波長帯の面発光型半導体レーザを形成できることがわかった。

【0052】

なお前述のように、このような面発光型半導体レーザは、MOCVD法で成長させることができるが、MBE法等の他の成長方法を用いることもできる。また活性層の積層構造として、3重量子井戸構造(TQW)の例を示したが、他の井戸数の量子井戸を用いた構造(SQW、MQW)等を用いることもできる。

【0053】

レーザの構造も他の構造にしてもかまわない。また共振器長は λ の厚さとしたが $\lambda/2$ の整数倍とすることができる。望ましくは λ の整数倍である。また半導体基板としてGaAsを用いた例を示したが、InPなどの他の半導体基板を用いた場合でも上記の考え方を適用できる。反射鏡の周期は他の周期でも良い。

【0054】

なおこの例では活性層として、主たる元素がGa、In、Asよりなる層、すなわち $Ga_xIn_{1-x}As$ (GaInAs活性層) の例を示したが、より長波長のレーザ発振を行うためには、Nを添加し主たる元素がGa、In、N、Asからなる層 (GaInNAs活性層) とすればよい。

【0055】

実際にGaInNAs活性層の組成を変えることにより、1.3 μm帯、1.55 μm帯のそれぞれにおいて、レーザ発振を行うことが可能であった。組成を検討することにより、さらに長波長の例えば1.7 μm帯の面発光レーザも可能となる。

【0056】

また、活性層にGaAsSbを用いてもGaAs基板上に1.3 μm帯面発光レーザを実現できる。このように波長1.1 μm~1.7 μmの半導体レーザは従来適した材料がなかったが、活性層に高歪のGaInAs、GaInNAs、GaAsSbを用い、かつ、非発光再結合防止層を設けることにより、従来安定発振が困難であった波長1.1 μm~1.7 μm帯の長波長領域において、高性能な面発光レーザを実現できるようになった。

【0057】

次に本発明の光送受信システムに適用される発光素子である長波長帯面発光型半導体レーザの他の構成について、図3を用いて説明する。

【0058】

この場合も図1の場合と同様に面方位(100)のn-GaAs基板を使用している。それぞれの媒質内における発振波長λの1/4倍の厚さ(λ/4の厚さ)でn-Al_xGa_{1-x}As(x=0.9)とn-Al_xGa_{1-x}As(x=0)を交互に35周期積層したn-半導体分布布拉ック反射鏡(Al_{0.9}Ga_{0.1}As/GaAs下部反射鏡)を形成し、その上にλ/4の厚さのn-Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}(x=0.5, y=1)層を積層した。この例ではn-Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}(x=0.5, y=1)層も下部反射鏡の一部であり低屈折率層となっている。

【0059】

そしてその上に、アンドープ下部GaAsスペーサ層と、3層のGa_xIn_{1-x}

$N_y A_s$ $1-y$ 量子井戸層である活性層（量子井戸活性層）と $G_a A_s$ バリア層（15 nm）から構成される多重量子井戸活性層（この例では3重量子井戸（TQW））と、アンドープ上部 $G_a A_s$ スペーサ層とが積層されて、媒質内における発振波長の1波長分の厚さ（ λ の厚さ）の共振器を形成している。

【0060】

さらにその上に、p-半導体分布プラグ反射鏡（上部反射鏡）が形成されている。

【0061】

上部反射鏡は、被選択酸化層となる $A_1 A_s$ 層を、 $G_a I_n P$ 層と $A_1 G_a A_s$ 層で挟んだ $3\lambda/4$ の厚さの低屈折率層（厚さが $(\lambda/4 - 15\text{ nm})$ の C ドープ $p - G_a_x I_n_{1-x} P_y A_s$ $1-y$ ($x = 0.5, y = 1$) 層、C ドープ $p - A_1_z G_a_{1-z} A_s$ ($z = 1$) 被選択酸化層（厚さ 30 nm）、厚さが $(2\lambda/4 - 15\text{ nm})$ の C ドープ $p - A_1_x G_a_{1-x} A_s$ 層 ($x = 0.9$)）と、厚さが $\lambda/4$ の $G_a A_s$ 層（1周期）と、C ドープの $p - A_1_x G_a_{1-x} A_s$ 層 ($x = 0.9$) と $p - A_1_x G_a_{1-x} A_s$ ($x = 0$) 層をそれぞれの媒質内における発振波長の $1/4$ 倍の厚さで交互に積層した周期構造（22周期）とから構成されている半導体分布プラグ反射鏡 ($Al_{0.9}Ga_{0.1}As/GaAs$ 上部反射鏡) である。

【0062】

なおこの例においても、図3では複雑になるので図示することは省略しているが、半導体分布プラグ反射鏡の構造は、図2に示したような低屈折率層（屈折率小の層）と高屈折率層（屈折率大の層）の間に、屈折率が小と大の間の値をとる材料層 $A_1_z G_a_{1-z} A_s$ ($0 \leq y < z < x \leq 1$) を設けたものである。

【0063】

そして、最上部の、 $p - A_1_x G_a_{1-x} A_s$ ($x = 0$) 層は、電極とコンタクトを取るためのコンタクト層（p-コンタクト層）としての役割も持たせている。

【0064】

ここで量子井戸活性層の I_n 組成 x は 37%、 N （窒素）組成は 0.5% とした。また量子井戸活性層の厚さは 7 nm とした。

【0065】

またこの面発光型半導体レーザの成長方法はMOCVD法で行った。半導体レーザの各層を構成する原料には、TMA（トリメチルアルミニウム）、TMG（トリメチルガリウム）、TMI（トリメチルインジウム）、AsH₃（アルシン）、PH₃（フォスフィン）、そして窒素の原料にはDMHy（ジメチルヒドログリジン）を用いた。DMHyは低温で分解するので600°C以下のような低温成長に適しており、特に低温成長の必要な歪みの大きい量子井戸層を成長する場合に好ましい。なおキャリアガスにはH₂を用いた。

【0066】

またこの例では、GaInNAs層（量子井戸活性層）は540°Cで成長した。MOCVD法は過飽和度が高くNと他のV族を同時に含んだ材料の結晶成長に適している。またMBE法のような高真空を必要とせず、原料ガスの供給流量や供給時間を制御すれば良いので量産性にも優れている。

【0067】

さらにこの例では、所定の大きさのメサ部分をp-Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}（x=0.5, y=1）層に達するまで、p-Al_zGa_{1-z}As（z=1）被選択酸化層の側面を露出させて形成し、側面の現れたAl_zGa_{1-z}As（z=1）層を水蒸気で側面から酸化してAl_xO_y電流狭さく層を形成している。

【0068】

最後にポリイミド（絶縁膜）でメサエッチングで除去した部分を埋め込んで平坦化し、上部反射鏡上のポリイミドを除去し、p-コンタクト層上に光出射部を除いてp側電極を形成し、GaAs基板の裏面にn側電極を形成した。

【0069】

この例においては、被選択酸化層の下部に上部反射鏡の一部としてGa_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}（0<x<1, 0<y≤1）層が挿入している。例えばウェットエッチングの場合では、硫酸系エッチャントを用いれば、AlGaAs系に対してGaInPAs系はエッチング停止層として用いることができるため、Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}（0<x<1, 0<y≤1）層が挿入されていることで、選択酸化のためのメサエッチングの高さを厳密に制御できる。このため、均一性、再現性を高められ、低コスト化が図れる。

【0070】

またこの例の面発光型半導体レーザ（素子）を一次元または二次元に集積した場合、素子製作時における制御性が良好になることにより、アレイ内の各素子の素子特性の均一性、再現性も極めて良好になるという効果がある。

【0071】

なおこの例では、エッチングストップ層を兼ねる $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1, 0 < y \leq 1$) 層を上部反射鏡側に設けたが、下部反射鏡側に設けても良い。

【0072】

またこの例においても、上下反射鏡に挟まれた、キャリアが注入され再結合する活性領域（本実施例では上部及び下部スペーサ層と多重量子井戸活性層とからなる共振器）において、活性領域内には A_1 を含んだ材料を用いず、さらに下部及び上部反射鏡の低屈折率層の最も活性層に近い層を $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1, 0 < y \leq 1$) の非発光再結合防止層としている。つまりこの例では、活性領域内及び反射鏡と活性領域との界面に、 A_1 を含まない構成としているので、キャリア注入時に、 A_1 に起因していた結晶欠陥が原因となる非発光再結合を低減させることができる。

【0073】

なお反射鏡と活性領域との界面に A_1 を含まない構成を、この例のように上下反射鏡に適用することが好ましいが、いずれか一方の反射鏡に適用するだけでも効果がある。またこの例では、上下反射鏡とも半導体分布プラグ反射鏡としたが、一方の反射鏡を半導体分布プラグ反射鏡とし、他方の反射鏡を誘電体反射鏡としても良い。

【0074】

さらにこの例でも、 $GaAs$ 基板と活性層との間の下部反射鏡に図1の例の場合と同様の考えを適用したので、活性層の成長時に問題となる A_1 に起因する結晶欠陥の活性層への這い上がりによる悪影響が押さえられ、活性層を高品質に結晶成長することができる。

【0075】

なお、このような非発光再結合防止層は、図1、図3のいずれの構成においても半導体分布プラッタ反射鏡の一部を構成するので、その厚さは、媒質内における発振波長 λ の1/4倍の厚さ（ $\lambda/4$ の厚さ）としている。あるいはそれを複数層も設けても良い。

【0076】

以上の説明より明らかのように、このような構成により、発光効率は高く、信頼性は実用上十分な面発光型半導体レーザが得られた。また、半導体分布プラッタ反射鏡の低屈折率層のすべてではなく、少なくとも活性領域に最も近い部分をAlを含まない $Ga_xIn_{1-x}P_yAs_{1-y}$ ($0 < x < 1, 0 < y \leq 1$) の非発光再結合防止層としただけなので、反射鏡の積層数を特に増加させることなく、上記効果を得ることができた。

【0077】

またこのような構成にしても、ポリイミドの埋め込みは容易であるので、配線（この例ではP側電極）が段切れしにくく、素子の信頼性は高いものが得られる。

【0078】

このように製作した面発光型半導体レーザの発振波長は約1.3μmであった。

【0079】

この例では、主たる元素がGa、In、N、Asからなる層を活性層に用いた（GaInNAs活性層）ので、GaAs基板上に長波長帯の面発光型半導体レーザを形成できた。またAlとAsを主成分とした被選択酸化層の選択酸化により電流狭さくを行ったので、しきい値電流は低かった。

【0080】

被選択酸化層を選択酸化したAl酸化膜からなる電流狭さく層を用いた電流狭さく構造によると、電流狭さく層を活性層に近づけて形成することで電流の広がりを抑えられ、大気に触れない微小領域に効率良くキャリアを閉じ込めることができる。更に酸化してAl酸化膜となることで屈折率が小さくなり凸レンズの効果でキャリアの閉じ込められた微小領域に効率良く光を閉じ込めることができ、

極めて効率が良くなり、しきい値電流は低減できる。また容易に電流狭さく構造を形成できることから、製造コストを低減できる。

【0081】

以上の説明から明らかなように図3のような構成においても図1の場合と同様に、1. $3 \mu\text{m}$ 帯の面発光型半導体レーザを実現でき、しかも低消費電力で低コストの素子が得られる。

【0082】

なお、図3の面発光型半導体レーザも図1の場合と同様にMOCVD法で成長させることができるが、MBE法等の他の成長方法を用いることもできる。また窒素の原料に、 DMHy を用いたが、活性化した窒素や NH_3 等他の窒素化合物を用いることもできる。

【0083】

さらに活性層の積層構造として3重量子井戸構造(TQW)の例を示したが、他の井戸数の量子井戸を用いた構造(SQW、DQW、MQW)等を用いることもできる。レーザの構造も他の構造にしてもかまわない。

【0084】

また図3の面発光型半導体レーザにおいて、 GaInNAs 活性層の組成を変えることで、1. $55 \mu\text{m}$ 帯、更にはもっと長波長の1. $7 \mu\text{m}$ 帯の面発光型半導体レーザも可能となる。 GaInNAs 活性層にTl、Sb、Pなど他のIII-V族元素が含まれていてもかまわない。また活性層に GaAsSb を用いても、 GaAs 基板上に1. $3 \mu\text{m}$ 帯の面発光型半導体レーザを実現できる。

【0085】

なお活性層に GaInAs を用いた場合、従来1. $1 \mu\text{m}$ までが長波長化の限界と考えられていたが、600℃以下の低温成長により高歪の GaInAs 量子井戸活性層を従来よりも厚く成長することが可能となり、波長は1. $2 \mu\text{m}$ まで到達できる。このように、波長1. $1 \mu\text{m}$ ～1. $7 \mu\text{m}$ の半導体レーザは従来適した材料がなかったが、活性層に高歪の GaInAs 、 GaInNAs 、 GaAsSb を用い、かつ非発光再結合防止層を設けることにより、従来安定発振が困難であった波長1. $1 \mu\text{m}$ ～1. $7 \mu\text{m}$ 帯の長波長領域において、高性能な面発

光レーザを実現できるようになり、光通信システムへの応用ができるようになつた。

【0086】

図4はこのような長波長帯面発光半導体レーザ素子を、面方位(100)のn-GaAsウエハに多数のチップとして形成した例、ならびにレーザ素子チップを示したものである。ここで示したレーザ素子チップには、1~n個のレーザ素子が形成されているが、その個数nはその用途に応じて、数ならびに配列方法が決められる。

【0087】

図5はレーザ発振波長が1.1μm帯~1.7μm帯の長波長帯面発光半導体レーザを用いた光送受信システムの一例である。この例では発光光源であるレーザ素子発光部はA地点に設置されている。出射された光信号は光ファイバーに光カップリングされ、図中太矢印で示した送信方向に伝送される。そして光ファイバーの終端部であるB地点に設置された受光ユニットであるフォトダイオード等の受光素子の光ディテクタ部に光カップリングされ、光送受信システムとして機能する。この例は発光光源の設置場所Aと受光ユニットの設置場所Bは、光ファイバーによって直線で結ばれる例である。これを模式的に図6のように示す。すなわち図の黒丸A、Bはそれぞれ発光光源と受光ユニットの設置場所である。黒太線は光ファイバーである。

【0088】

通常このように発光光源と受光ユニットは伝送路である光ファイバーで光学的にカップリングされ光送受信システムとして機能するが、本発明のレーザ発振波長が1.1μm帯~1.7μm帯の長波長帯面発光半導体レーザを用いた光送受信システムにおいては、数10m~数10kmにわたって伝送路が形成され、その間に障害物が全くないとは限らない。例えば図7は障害物A、障害物Bが存在し、発光光源の設置場所Aと受光ユニットの設置場所Bが伝送路で一直線につなぐことができず、伝送路を直角に曲げた例を示している。

【0089】

このような場合、伝送路を直角に曲げる部分は無理に直角に曲げるとファイバ

ーが破損し、伝送路として機能しなくなる。つまり角度が付くような曲げ方を行うとファイバーが破損し、伝送路として機能しなくなる。またこの部分に伝送路を曲げる反射部材を設けて光の進行方向を曲げることはできるが、コスト高になる。

【0090】

本発明ではこのような点に鑑み、反射部材を設けるようなことは行わず、また伝送路の機能を損ねないような伝送路の曲げ方を提案するものである。

【0091】

図8は本発明の一例である。この場合、障害物Cが存在し、発光光源の設置場所Aと受光ユニットの設置場所Bが伝送路で一直線につなぐことができない。しかしながら本発明ではこの例に示すように、伝送路の光ファイバーを角度を付けずに曲げて発光光源の設置場所Aと受光ユニットの設置場所Bをつなぐようにしている。このようにつなぐことにより、伝送路の光ファイバーは破損せず、また障害物Cを避けて通ることができ、良好な光送受信システムを構築できる。

【0092】

図9は本発明の他の例である。この場合も、障害物D、障害物Eが存在し、発光光源の設置場所Aと受光ユニットの設置場所Bが伝送路で一直線につなぐことができない。しかしながら本発明ではこの例に示すように、伝送路の光ファイバーを角度を付けずに曲げて発光光源の設置場所Aと受光ユニットの設置場所Bをつなぐようにしている。

【0093】

本発明では、このように連続的に伝送路を曲げるようにしており、その伝送路が階段状に角度がついて曲げられることはない。

【0094】

なお、このように連続的に伝送路を曲げる場合においても、その曲げられる曲率に全く条件がないわけではない。本発明ではこの点について銳意検討を行った結果、図8や図9に示した伝送路は、直径50cm以上の円の一部をなすような曲率の伝送路にしておかないと、破損したり、あるいは良好にレーザ光を伝送できないことがわかった。言い換えるとこのような光送受信システムを構築する場

合に、その伝送路は直径 50 cm 以上 の円の一部をなすような曲率の伝送路にしておけば、方向を変えるための反射部材などを特別に設けなくても、図 9 に示したように障害物を避けながら伝送路を配置でき、低コストでしっかり機能する良好な光送受信システムを構築できるということである。

【0095】

【発明の効果】

(請求項 1 に対応した効果)

コンピュータ・ネットワーク、長距離大容量通信の幹線系など光ファイバー通信が期待されているレーザ発振波長が 1.1 μm 帯～1.7 μm 帯の分野において、動作電圧、発振閾値電流等を低くでき、レーザ素子の発熱も少なく安定した発振ができる面発光型半導体レーザおよびそれを用いた光送受信システムが存在しなかつたが、本発明のように半導体分布プラグ反射鏡を工夫することにより、動作電圧、発振閾値電流等を低くでき、レーザ素子の発熱も少なく安定した発振ができ、また低コストで実用的な 2 地点間光送受信システムが実現できた。

さらに、このような 2 地点間光送受信システムを構築するにあたり、伝送路の方向変換は、光ファイバーそのものを角度を付けずに曲げて行うようにしたので、ファイバーを破損することなく容易かつ低コストで 2 地点間光送受信システムが実現できた。

【0096】

(請求項 2 に対応した効果)

コンピュータ・ネットワーク、長距離大容量通信の幹線系など光ファイバー通信が期待されているレーザ発振波長が 1.1 μm 帯～1.7 μm 帯の分野において、安定して使用できる長波長帯面発光半導体レーザおよびそれを用いた光送受信システムが存在しなかつたが、本発明のように、非発光再結合防止層を設けてなる面発光型半導体レーザ素子チップとすることにより安定した発振が可能となり、これを発光光源とした実用的な光送受信システムが実現できた。

さらに、このような 2 地点間光送受信システムを構築するにあたり、伝送路の方向変換は、光ファイバーそのものを角度を付けずに曲げて行うようにしたので、ファイバーを破損することなく容易かつ低コストで 2 地点間光送受信システム

が実現できた。

【0097】

(請求項3に対応した効果)

このような2地点間光送受信システムを構築するにあたり、伝送路の方向変換は、光ファイバーを曲げて行うようにしたので、容易かつ低成本の2地点間光送受信システムとなるとともに、光ファイバーを連続的に曲げるようにして伝送路の機能を損ねたり、ファイバーを破損したりすることなく、良好な光送受信システムとすることができた。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施形態に係る長波長帯面発光半導体レーザの素子部断面図である

【図2】

本発明の一実施形態に係る長波長帯面発光半導体レーザの半導体分布プラグ反射鏡の構成の部分断面図である。

【図3】

本発明の一実施形態に係る長波長帯面発光半導体レーザの他の構成の素子部断面図である。

【図4】

本発明の一実施形態に係る長波長帯面発光半導体レーザ素子を形成したウエハ基板ならびにレーザ素子チップを示す平面図である。

【図5】

発光光源と受光ユニットを伝送路で直線的に結んだ光送受信システムの例である。

【図6】

上記光送受信システムの模式図である。

【図7】

障害物をさけるために発光光源と受光ユニットを結ぶ伝送路を直角に曲げた例である。

【図8】

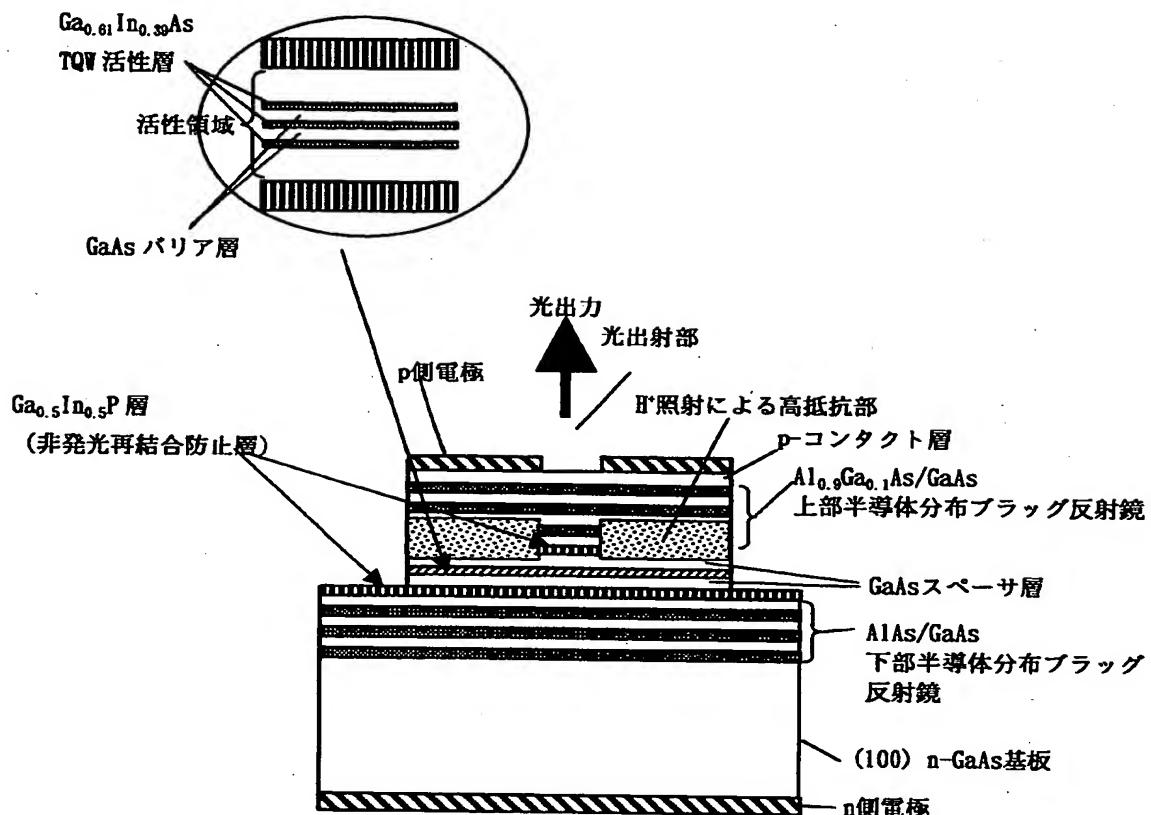
本発明の光送受信システムの一例であり、障害物をさけて発光光源と受光ユニットを伝送路を曲げながら結ぶようにしたるものである。

【図9】

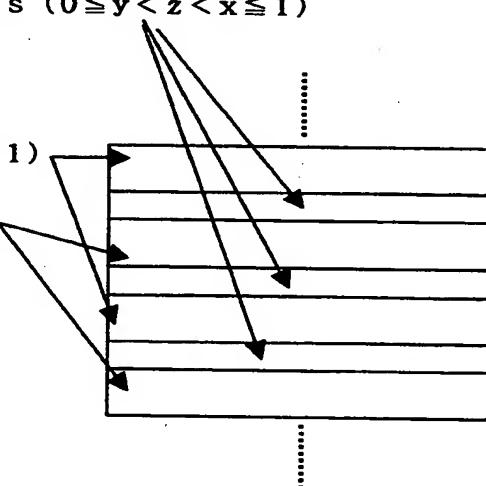
本発明の他の光送受信システムの例であり、障害物をさけて発光光源と受光ユニットを伝送路を曲げながら結ぶようにしたるものである。

【書類名】 図面

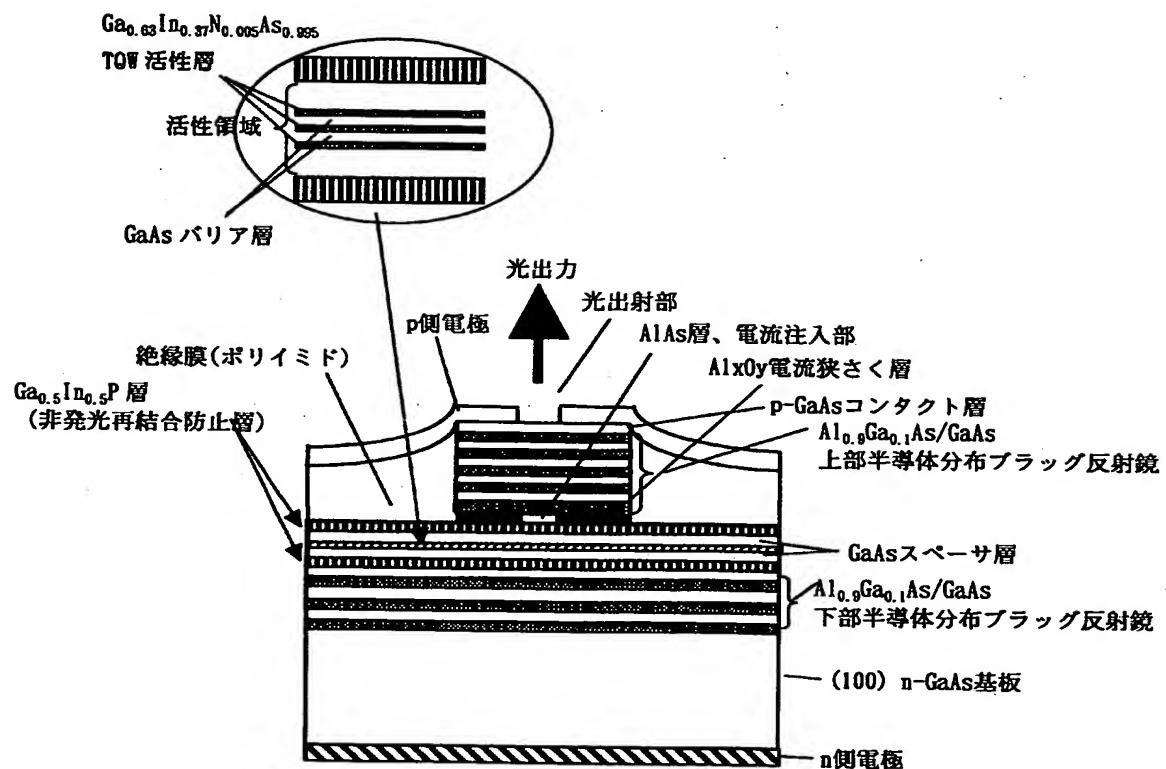
【図1】



【図2】

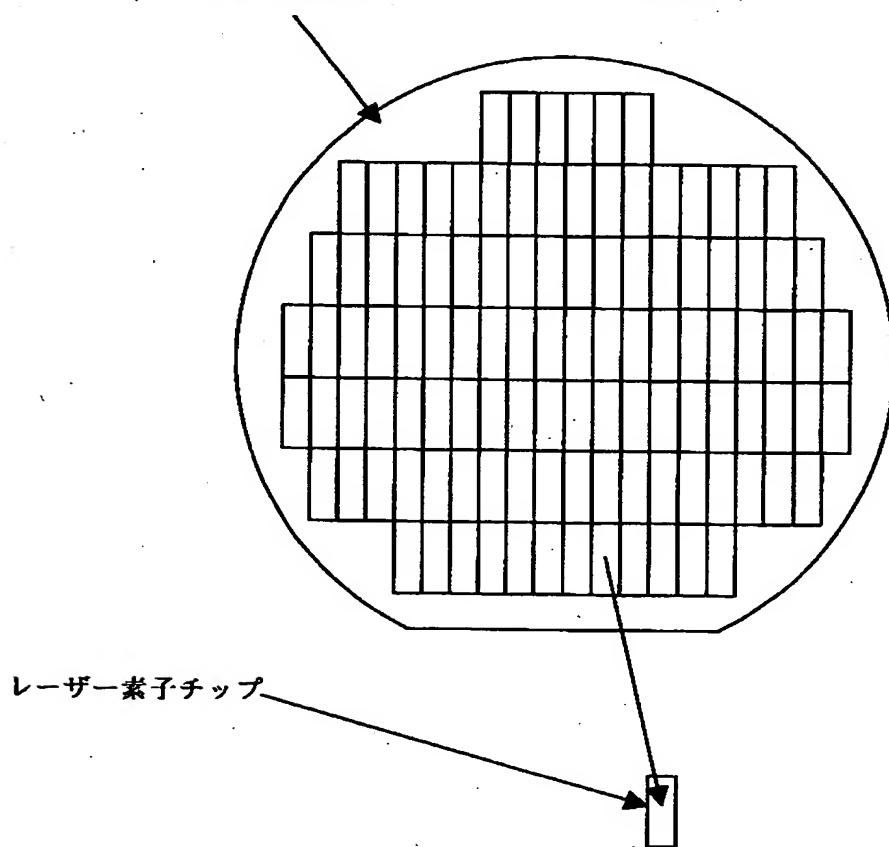
屈折率が小と大の間の値をとる材料層 $Al_zGa_{1-z}As$ ($0 \leq y < z < x \leq 1$)屈折率が大の材料層 $Al_yGa_{1-y}As$ ($0 \leq y < x \leq 1$)屈折率が小の材料層 $Al_xGa_{1-x}As$ ($0 < x \leq 1$)

【図3】

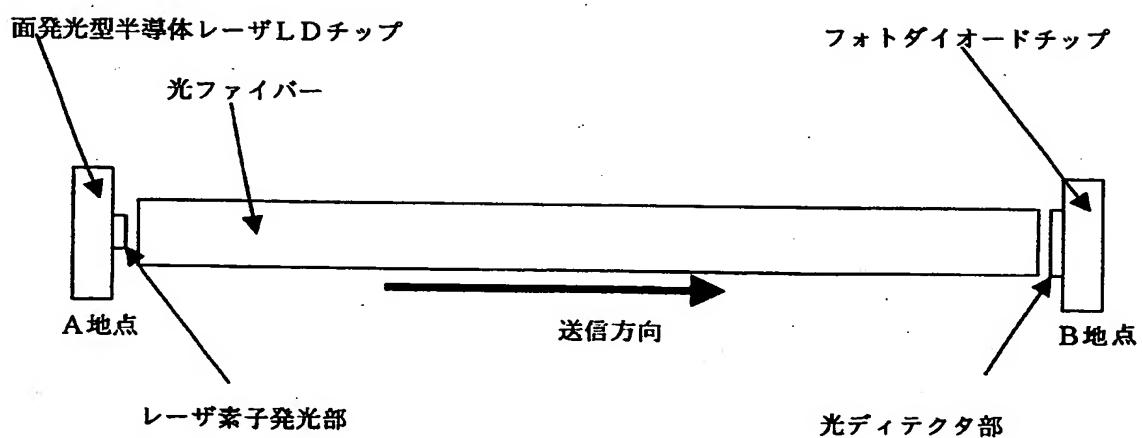


【図4】

レーザー素子を形成した(100)n-GaAsウエハ



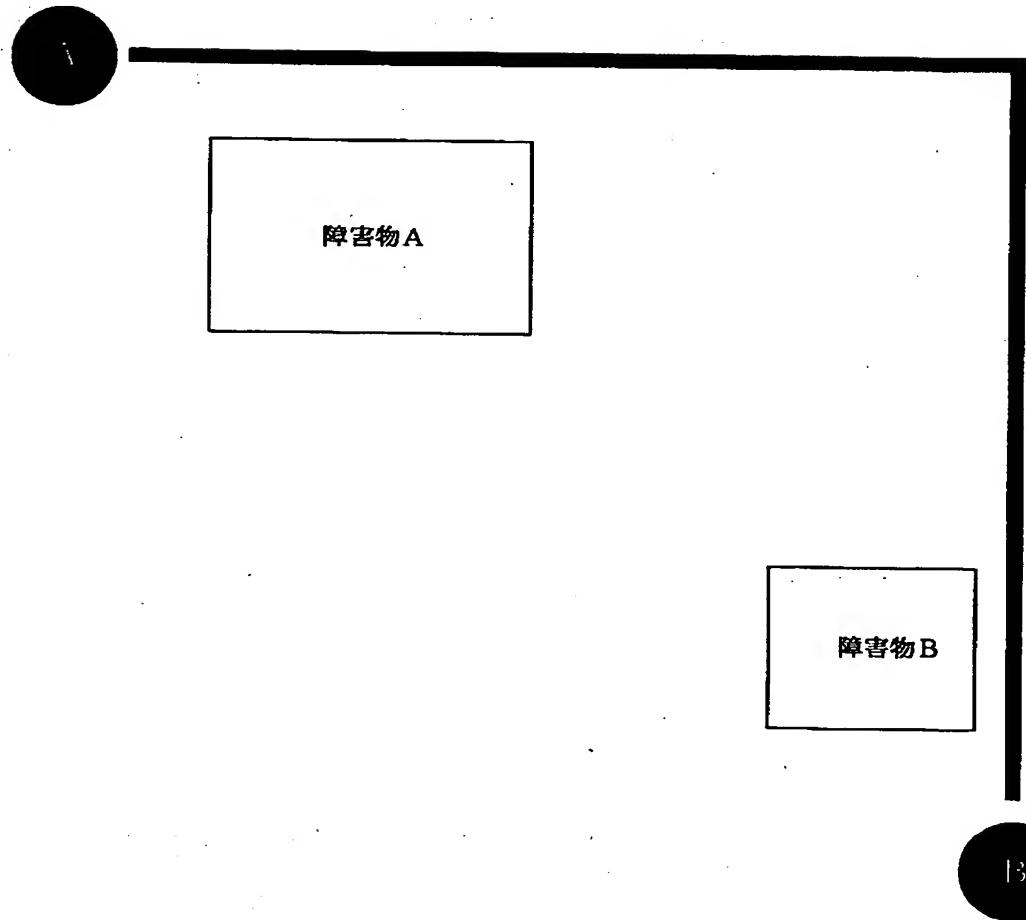
【図5】



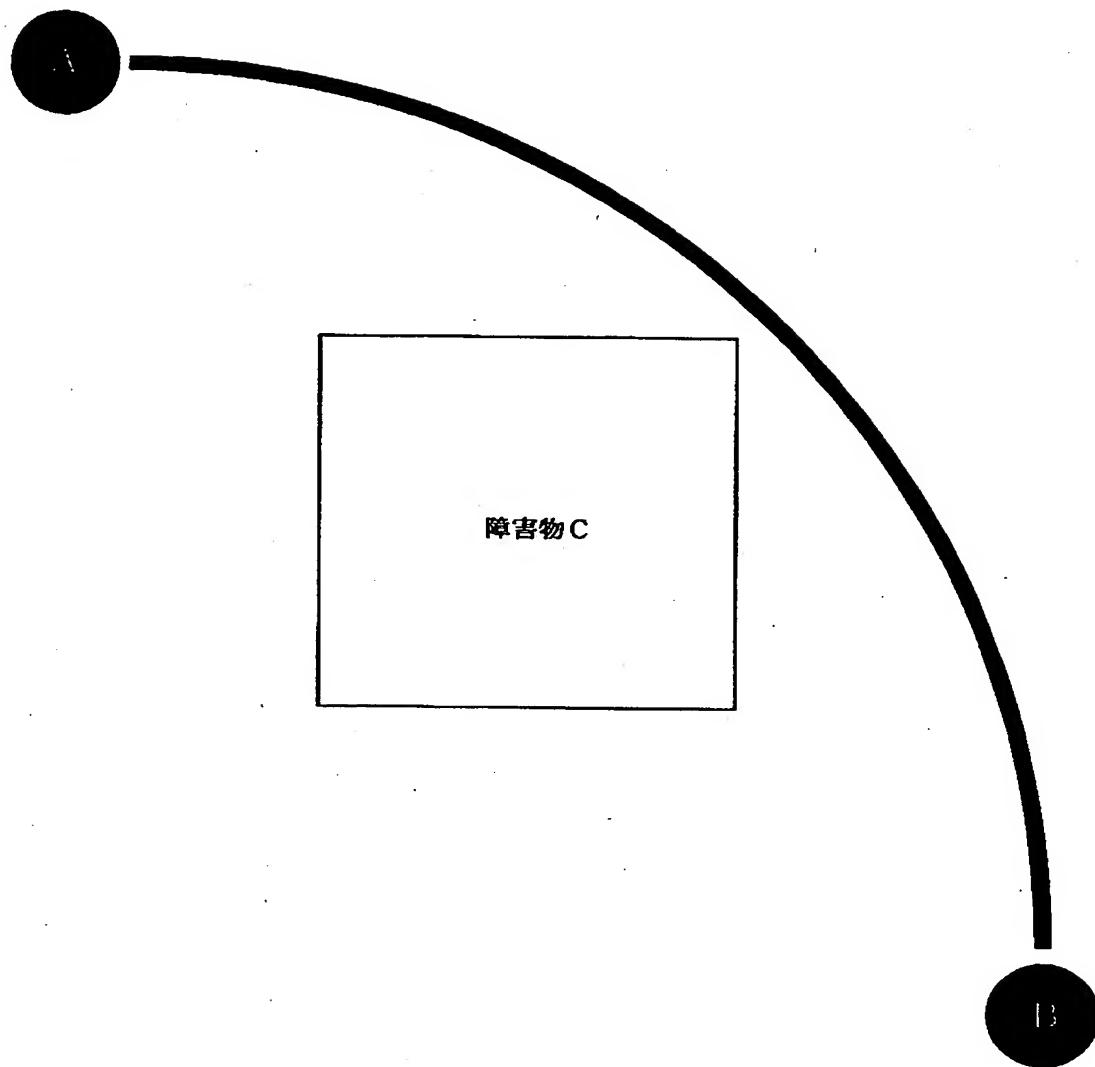
【図6】



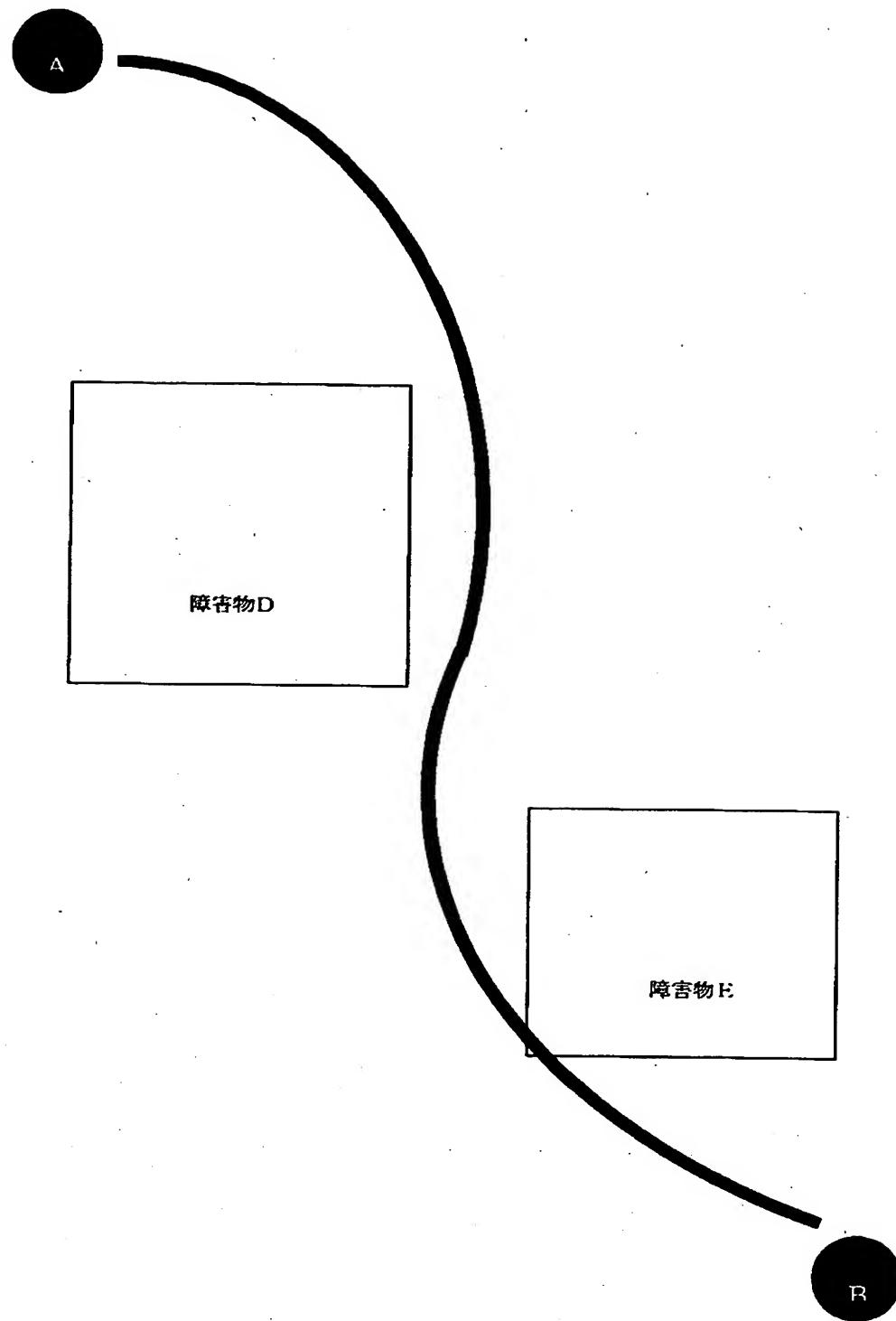
【図7】



【図8】



【図9】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 2つの場所をつなぐ光送受信システム構築が容易にできるようにする

【解決手段】 発光光源は、発振波長が $1.1 \mu\text{m} \sim 1.7 \mu\text{m}$ であり、光を発生する活性層の上部及び下部に設けられた反射鏡を含んだ共振器構造を有する面発光型半導体レーザ素子チップとする。反射鏡はそれを構成する材料層の屈折率が小／大と周期的に変化し入射光を光波干渉によって反射する半導体分布布拉ッグ反射鏡であるとともに、屈折率が小の材料層は $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ ($0 < x \leq 1$) 、屈折率が大の材料層は $\text{Al}_y\text{Ga}_{1-y}\text{As}$ ($0 \leq y < x \leq 1$) とする。また、発光光源に光信号を伝送するための光ファイバー伝送路を光学的にカップリングさせるとともに、伝送路の発光光源と反対側に光学的にカップリングさせた受光ユニットを設ける。ここで、伝送路の方向変換は、光ファイバーそのものを角度を付けずに曲げて行うとする。

【選択図】 図8

【書類名】 手続補正書
【提出日】 平成13年 3月26日
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】

【出願番号】 特願2001- 53225

【補正をする者】

【識別番号】 000006747

【氏名又は名称】 株式会社リコー

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 特許願

【補正対象項目名】 発明者

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 関谷 卓朗

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 横井 彰

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 加藤 正良

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 古田 輝幸

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 宮垣 一也

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 金井 健

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 和多田 篤行

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 佐藤 俊一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 鈴木 幸栄

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 菅原 哲

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
株式会社リコー内

【氏名】 鬼地 秀一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

株式会社リコー内

【氏名】 佐藤 新治

【その他】 発明者の住所又は居所、氏名に変更はないが、順番を変更したいので本補正をします。

【ブルーフの要否】 要

出願人履歴情報

識別番号 [000006747]

1. 変更年月日 1990年 8月24日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
氏 名 株式会社リコー